２０２６年１１月

芝浦メカトロニクス株式会社
芝浦エレテック株式会社

「SEMICON Japan 2026」出展のご案内

拝　啓

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

芝浦メカトロニクスグループは、12 月 9 日（水）～ 11 日（金）、東京ビックサイトで開催される『SEMICON Japan 2026』に出展いたします。

是非この機会に、芝浦メカトロニクスグループの新しい技術をご覧いただきたく、ご来場をお待ち申し上げております。

敬　具

－ 記 －

日　　時　：　2026 年 12 月 9 日（水）～ 11 日（金）　10：00～17：00

会　　場　：　東京ビッグサイト　東 Hall 1～3,7,8　西 Hall1～4、会議棟
有明セントラルタワーホール＆カンファレンス 4F

展示ブース　：　総合ゾーン　東展示棟　Hall2　小間番号 E2222

Web サイト　：　https://www.semiconjapan.org/jp/

出 展 品 目　：

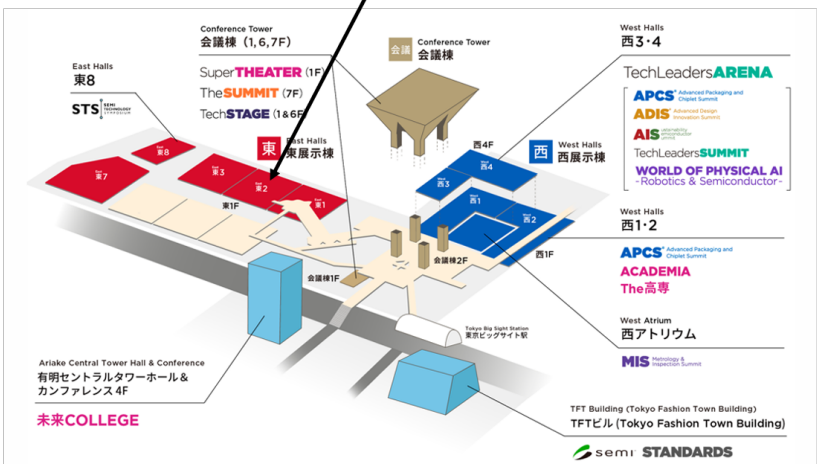
総合ゾーン

【前工程設備】（パネル展示）
枚葉式ウェーハ洗浄装置(SC300 series)
フォトマスクエッチング装置＆洗浄装置(ARES ® series & ARTS ® /MC150)
高温リン酸エッチング装置(SC300-HT series)
等方性エッチング/低温アッシング装置(CDE/ICE series)
FOSB/FOUP洗浄装置(FOC300)
パネル用ウェットスピン装置(PD-series)
インクジェット技術

【後工程設備】（パネル展示）
高精度ボンダラインナップ
ハイエンド2.XDパッケージボンダ(TFC-6500/6500-W)
ハイエンドウェーハレベルパッケージボンダ(TFC-6600)
ハイブリッド接合前処理装置(HSM-1000)
ハイブリッドボンダ(TFC-6800)
パネルレベルパッケージボンダ(TFC-9300)

【真空】（パネル・モックアップ展示）
AIサーバー向けスパッタリング装置ラインナップ
半導体用スパッタリング装置(BM-1400W)

【サービス】（実機・パネル展示）
芝浦エレテックの装置サービス
レチクル(フォトマスク)移載機
ウェーハマーカ(LAY-775 series)



以　上

【ご注意】

ご来場の際は、展示会 Web サイトから事前登録していただきますようお願いいたします。

【お問い合わせ先】
芝浦エレテック株式会社　経営企画部　企画グループ
e-mail：　esc@shibaura.co.jp　　web サイト：　https://www.shibaura.co.jp/eletec/